(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
Bureau international

(43) Date de la publication internationale
29 décembre 2005 (29.12.2005)

PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 2005/124826 A1

(51) Classification internationale des brevets[7] : H01L 1/20

(21) Numéro de la demande internationale :
PCT/FR2005/050411

(22) Date de dépôt international : 2 juin 2005 (02.06.2005)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :
0451085 2 juin 2004 (02.06.2004) FR

(71) Déposant *(pour tous les États désignés sauf US)* : **TRACIT TECHNOLOGIES** [FR/FR]; Centr'Alp, 52, rue Corporat, F-38430 MOIRANS (FR).

(72) Inventeurs; et

(75) Inventeurs/Déposants *(pour US seulement)* : **ASPAR, Bernard** [FR/FR]; 110 Lotissement le Hameau des Ayes, F-38140 RIVES (FR). **LAGAHE-BLANCHARD, Chrystelle** [FR/FR]; Route de la Cascade, F-38134 SAINT-JOSEPH-DE-RIVIERE (FR).

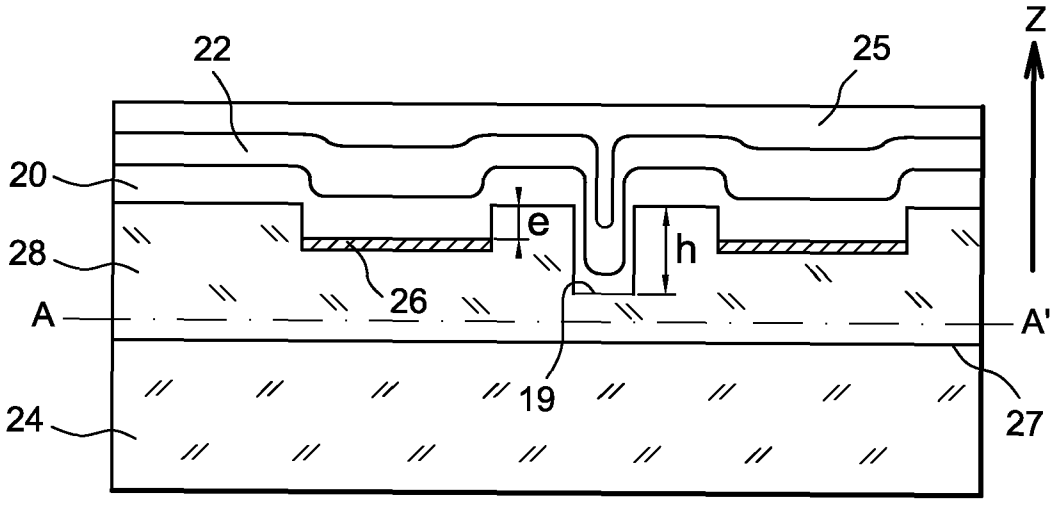
(74) Mandataire : **POULIN, Gérard**; Brevalex, 3, rue du Docteur Lancereaux, F-75008 PARIS (FR).

(81) États désignés *(sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible)* : AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM,

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: METHOD FOR TRANSFERRING PLATES

(54) Titre : PROCEDE DE TRANSFERT DE PLAQUES



(57) Abstract: The invention relates to a method for preparing a thin layer (28) or a chip to be transferred to another substrate. According to said method, at least one layer, a so-called adhesion layer (25), and at least one other layer, a so-called first boundary layer (22), is formed above the surface of the thin layer or the chip, the adhesion layer consisting of a material which is etched in a selective manner in relation to the material of the boundary layer.

(57) Abrégé : L'invention concerne un procédé de préparation d'une couche mince (28) ou d'une puce à transférer sur un autre substrat, ce procédé comportant la réalisation, au-dessus de la surface de ladite couche mince ou de ladite puce, d'au moins une couche, dite couche d'adhérence (25), et d'au moins une couche, dite première couche d'arrêt (22), la couche d'adhérence étant en un matériau dont la gravure présente une sélectivité par rapport au matériau de la couche d'arrêt.

WO 2005/124826 A1

PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) États désignés *(sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible)* **:** ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée :

— *avec rapport de recherche internationale*

— *avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont reçues*

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.